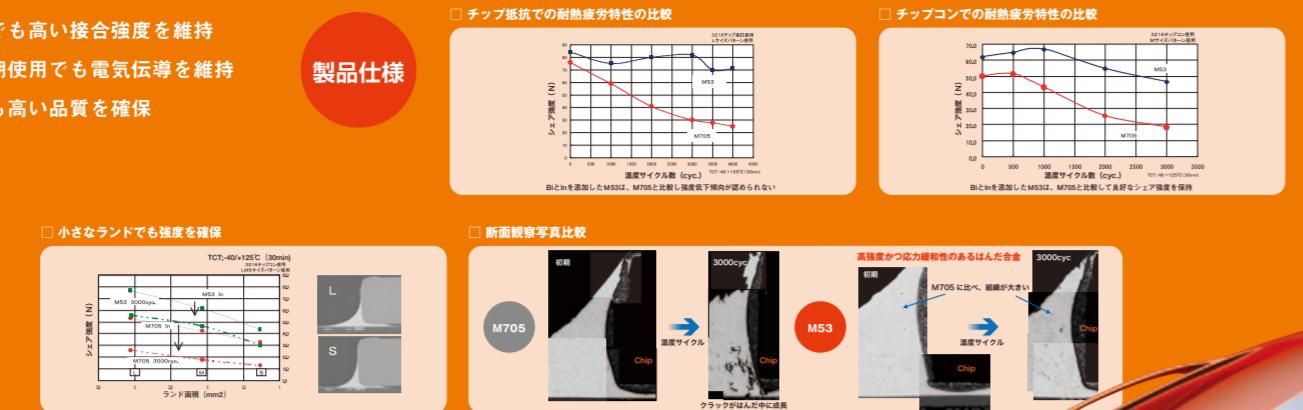


M53

車載搭載製品の軽薄短小化にも対応『M53』ペースト

特長

- 耐熱疲効特性に優れ、過酷な使用条件でも高い接合強度を維持
- 熱疲労によるクラック進展を抑制、長期使用でも電気伝導を維持
- ラント面積の小さな軽薄短小化設計でも高い品質を確保

SMIC
Senju Metal Industry Co., Ltd.

特長

腐食起因のウィスカを抑制する『ES-100SA』

- 高温高湿下での、腐食が原因で発生するウィスカを抑制
- フックスに添加した防腐抑制剤がはんだ面上に吸着し、高温高湿環境下での酸化を抑制
- ウィスカ発生の起因となるハロゲン成分を減らしつつ、はんだ潤滑性を確保
- 防腐抑制剤を有するフラックスで、ウィスカ発生を低減
- フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しております

ES-100SA
特許：4325746

次世代実装を、信頼でつなぐ

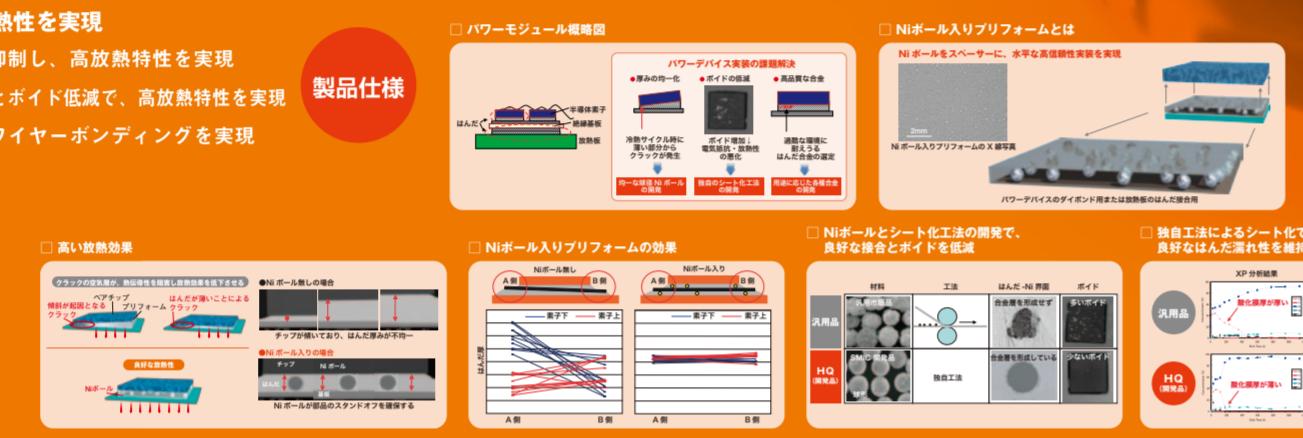
自動車

AUTOMOBILE

はんだのクラック発生を抑制し、高放熱性を実現

特長

- はんだ厚や傾斜に起因するクラックを抑制し、高放熱性を実現
- プリフォームによる一定のはんだ厚の確保とボイド低減で、高放熱性を実現
- 傾斜なきペアチップで、信頼性の高いワイヤーボンディングを実現



HQ

水平実装で、高放熱特性を約束する『Niボール入りプリフォーム』



MACROS

M40 & M46

コストを、徹底的に削減できる『M40』SPシリーズ

特長

- 高品質な低価格化を達成
- プロファイルの変更が不要
- 高速印刷が可能
- 短時間リフローが可能
- 生産歩留が安定

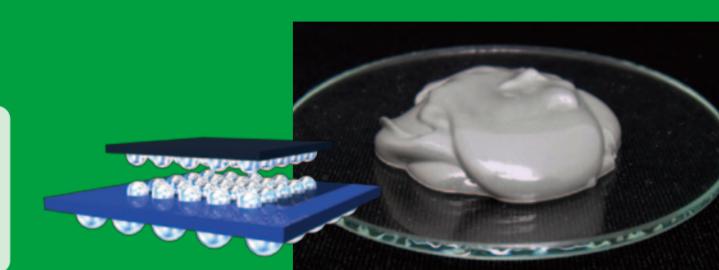
SMIC
Senju Metal Industry Co., Ltd.

3D実装POP用転写ペースト M705-NS V300

NSV300

Ball to Ball 実装での「未融合解決」

- 良好な転写性を有し、Ball-Ball 実装での未融合を激減
- POPやTMV Packageにも対応し、良好なはんだ付け性を実現
- 反りに強く、ハロゲンフリーでありながら、従来製品以上の性能



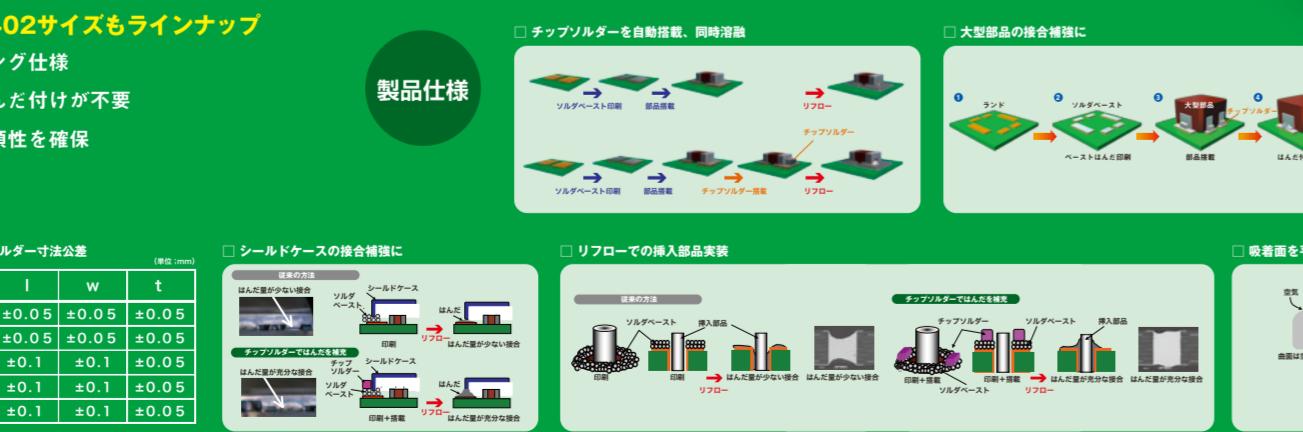
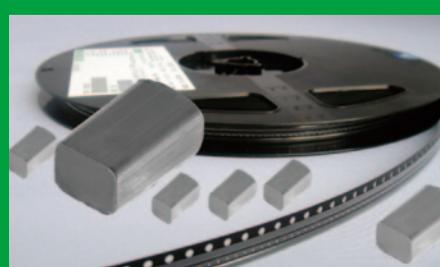
スマートフォン

SMARTPHONE

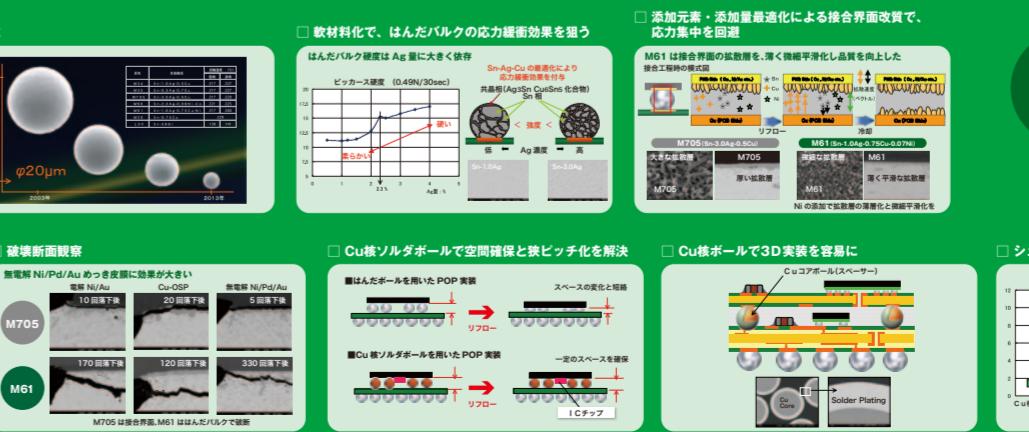


夢のイノベーションを、明日につなぐ

- はんだ量の不足が予測される実装に0402サイズもラインナップ
- SMDと一緒に自動搭載可能なテーピング仕様
- ソルダーベーストと一緒に溶融、追いはんだ付けが不要
- 適切なはんだ量の供給で、高い接続信頼性を確保



製品仕様



- モバイル機器など、落下的リスクの高い製品に
- 耐落下衝撃性に優れるソルダーボール
- 微細接続、高密度接続、高品質実装に対応
- あらゆる表面処理材料に対応

